

2024年12月4日
TOPPAN株式会社

TOPPAN、エレクトロニクス製造の国際展示会 「SEMICON Japan 2024」に出展

半導体関連のキーデバイスである FC-BGA 基板や、
次世代半導体パッケージ用部材、最先端の EUV フォトマスクを展示

TOPPAN ホールディングスのグループ会社である TOPPAN 株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:齊藤 昌典、以下 TOPPAN)は、2024年12月11日(水)から13日(金)に開催される「SEMICON Japan 2024」(会場:東京ビッグサイト)に出展します。

本展示会は、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車や IoT 機器などの SMART アプリケーションまでをカバーする、エレクトロニクス製造の国際展示会です。



社会の DX/SX の進展による全産業のデジタルシフトで、半導体をはじめとする電子デバイスの需要が拡大しています。半導体関連事業を手がける TOPPAN のエレクトロニクス事業本部では、半導体関連を中心としたキーデバイスの供給や、部材提供にとどまらないトータルソリューションの提案により、国内外のエレクトロニクスビジネス領域の顧客に対し、新たな価値を創造しています。

今回、TOPPAN グループブースでは、設計やフォトマスクといった半導体製造の前工程で使用される部材から、FC-BGA 基板、次世代半導体パッケージといった後工程で使われる部材など、幅広い製品やソリューションを紹介します。

また、会期中、SEMI ジャパンが主催する半導体業界特化の学生向け業界研究イベント「未来 COLLEGE」にも出展します。(東7ホール「未来 COLLEGE」内、ブース番号 20)

■ 主な展示内容

・FC-BGA 基板

FC-BGA (Flip Chip-Ball Grid Array) 基板は、LSI チップの高速化や多機能化を可能とする高密度半導体パッケージ基板で、サーバーCPU、ネットワーク機器、家庭用ゲーム機、CPU/GPU など、幅広いデジタル製品に使用されています。今回、TOPPAN グループブースでは、業界最大クラスの大型サブストレート(サイズ:98mm×95mm、90mm×90mm)を展示します。

・次世代半導体パッケージ

FC-BGA 基板上に複数の半導体チップを、インターポーザー(※1)を介して実装するチップレット構造の普及が期待されています。TOPPAN は、ガラスやその他の有機材料を用いた次世代半導体基板用の高生産性インターポーザーの開発に注力しています。TOPPAN グループブースでは、ガラスパネルに貫通孔と部品搭載用キャビティを形成したガラスパネル基板や、ガラスキャリアを用いた有機 RDL インターポーザーなどの次世代技術を紹介します。

・パワー半導体/ターンキーサービス

カーボンニュートラルの実現に向け、パワー半導体への注目が高まっています。TOPPAN では、2023年度より、国内ファンダリメーカーとの協業によるパワー半導体向けの受託製造ハンドリングサービスを開始しています。パワー半導体の設計から製造までを請け負うターンキーサービスにも対応します。

・EUV フォトマスク/ナノインプリントモールド

TOPPAN グループでフォトマスクの製造・販売を行うテクセンドフォトマスク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:二ノ宮 照雄)は、2000年代初頭から、業界に先駆けて EUV フォトマスクの研究、開発を行ってきました。今回、TOPPAN グループブースでは、半導体の微細化を牽引する EUV フォトマスクの展示を行います。また、半導体用フォトマスクで培った微細加工技術を活用した、ナノインプリント用モールドの展示も行います。

(株式会社トッパンフォトマスクは、2024年11月1日より、テクセンドフォトマスク株式会社に社名を変更しました)

https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2024/10/newsrelease241001_1.html

■ 「SEMICON Japan 2024」について

名称: SEMICON Japan 2024

会期: 2024年12月11日(水)~13日(金) 10:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト 東展示棟

主催: SEMI ジャパン

公式サイト: <https://www.semiconjapan.org/jp>

TOPPAN グループブース: 2129

・半導体業界特化の学生向け業界研究イベント「未来 COLLEGE」



<https://www.semijapanwfd.org/event/jobfair/y2024/>

※1 インターポーザー: 貫通電極によって表裏の回路を電氣的に接続するために用いられる基板

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上